

ナノメートルの技術に次の驚きを



KOKUSAI ELECTRICグループは、安全・快適で活力ある、 持続可能な社会の実現をめざし、技術と対話で価値を創造します。

当社は、株式会社日立国際電気から独立して、新たにKKRファンドのもとで半導体製造装置事業の専門メーカーとして2018年6月1日より「株式会社KOKUSAI ELECTRIC」を新たにスタートしました。

当社を取り巻く半導体の市場環境は、IoT社会の浸透、データセンター需要の増大や電子機器の多様化によるメモリー市場の拡大と、AI・自動運転・通貨マイニングなどの加速による幅広いデバイス市場の活性化により半導体全体の需要が拡大し、大きな転換期を迎えています。この市場環境の変化に伴い、半導体製造装置業界も新たな成長局面を進行しています。

当社は新生会社として、この大きな市場環境変化のお客さまニーズに、これまで培ってきた成膜技術をコアに先端技術でお応えし、成膜リーディングメーカーをめざしていきます。常にお客さま視点でのイノベーション企業として、スピーディーな事業オペレーションを展開し、高品質な製品・サービスの提供に努め、ますます高度化する社会インフラへ、テクノロジーで重要な責任を果たしてまいります。

今後とも皆さまの変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

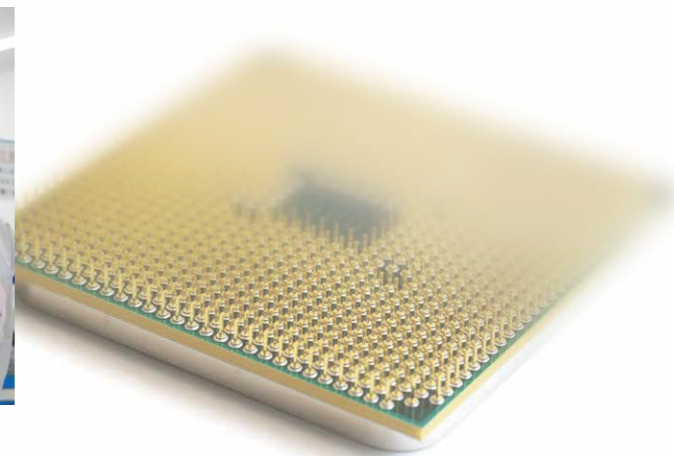
代表取締役 社長執行役員 かない ふみゆき
金井 史幸



- 1949年11月 国際電気(株)、設立
- 2000年10月 日立電子(株)・八木アンテナ(株)と合併し、社名を(株)日立国際電気に変更
- 2009年 3月 公開買付により、(株)日立国際電気が(株)日立製作所の連結子会社となる
- 2017年12月 公開買付により、HKEホールディングス(株)が(株)日立国際電気の株式26%を取得
- 2018年 5月 (株)日立国際電気がHKEホールディングス(株)の完全子会社となる
- 2018年 6月 会社分割により、(株)日立国際電気の成膜プロセスソリューション事業をHKEホールディングス(株)が承継し、社名を(株)KOKUSAI ELECTRICに変更

世界トップレベルの成膜技術を軸に、高品質な半導体製造装置を生産。

半導体は、シリコンで作られたウェーハと呼ばれる基板の表面に何層もの膜を重ねて回路を形成したものです。この薄い膜を形成する工程をサーマルプロセスといい、半導体形成において、もっとも重要な工程です。私たちKOKUSAI ELECTRICは、物理的限界値に近い10ナノメートルの微細加工技術をはじめとした世界トップレベルの成膜技術を活かした半導体製造装置を生産し、世界のトップメーカーに納入。半導体の高機能化、高性能化を支えています。



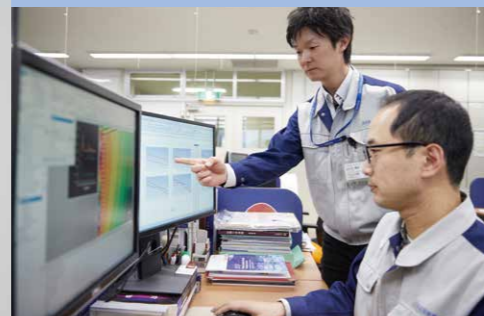
研究開発

自社の要素技術に加え、各研究機関と共同で次世代の高機能半導体技術の開発と、それを実現するための成膜技術、製造技術の開発を行っています。



設計

3DCADによる設計、流体シミュレーションなど先進技術を導入。自社の要素技術を最大限に活かし、お客様の声を製品に反映する装置の設計を行っています。



調達

装置の機種や仕様により必要な部品の種類や数はそれぞれ異なります。各地のビジネスパートナーから集められた1万5千点を超える部品を自動倉庫で管理しています。



製造

クラス5000のクリーンルームで多岐にわたる製品を製造しています。ユニット組立では、セルステーション生産方式を採用し、作業の効率化、安全性及び生産性の向上、生産スキームの最適化を推進しています。



出荷

すべての工程において、厳密な製品検査と出荷検査を実施。完成した装置は、環境にも配慮した輸送方法で世界へと出荷されます。



搬入・セットアップ

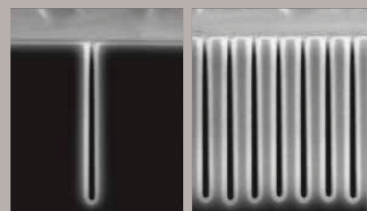
お客様の工場へ出向き、お客様の納期にあわせ、装置の搬入から組立、配線、試験・調整、プロセス立上げ作業を実施。約90%がアジアを中心とした海外のお客様であり、多くの社員が海外で活躍中です。



薄膜形成プロセス技術

BCD®(Balance Controlled Deposition)は、当社独自の次世代の新成膜ソリューションです。このBCD®技術により、次世代半導体プロセスに要求される低温処理、微細加工対応、高生産性を高次元で両立することが可能となり、幅広いアプリケーションへの展開が可能となります。

優れた段差被膜性



※BCDは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の日本における登録商標です。

主要製品

バッチプロセス装置



高品質成膜・高性能半導体製造装置
TSURUGI-C² 鋺®



高生産性縦型装置
AdvancedAce[®]-300



200mmウェーハ対応
バッチサーマル
プロセス装置

枚葉プロセス装置



枚葉プラズマ窒化・酸化装置
MARORA[®]



枚葉キュア・アニール装置
TANDUO[®]



枚葉アッシング装置
Lambda300

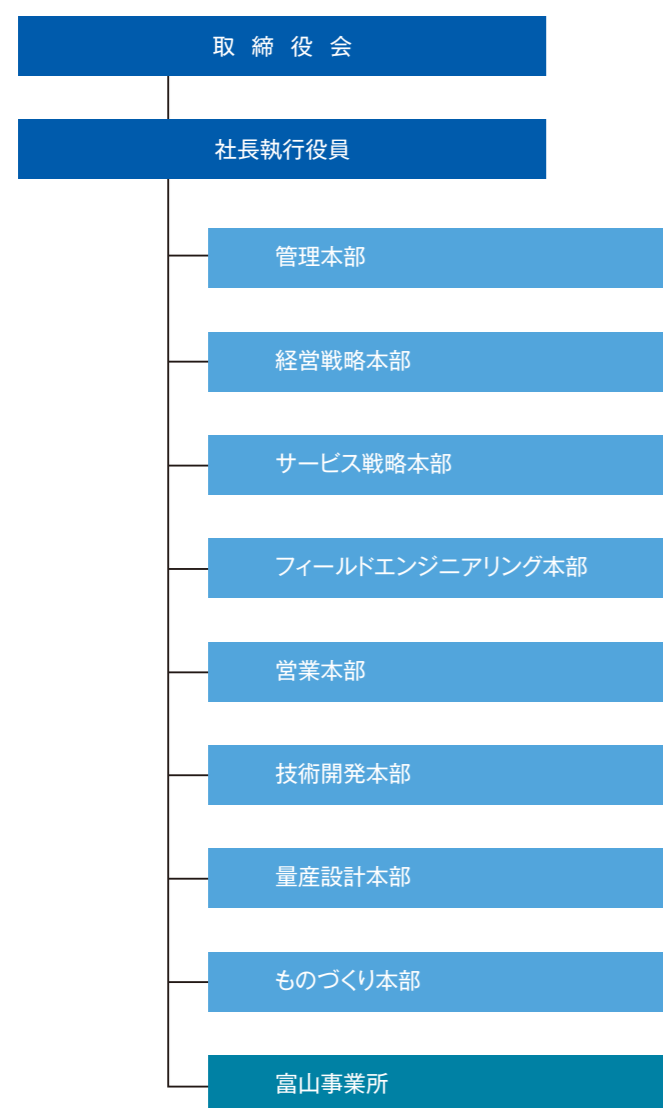
※TSURUGI-C²、鋺のロゴ、AdvancedAceは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の登録商標です。

※MARORA、TANDUOは株式会社 KOKUSAI ELECTRIC の登録商標です。

会社情報

| | |
|----------------|----------------------|
| 社名 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC |
| 設立 | 2017年2月2日 |
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 金井 史幸 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 従業員数 | 995名(個別) |
| (2019年9月30日時点) | 1,940名(連結) |
| 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |

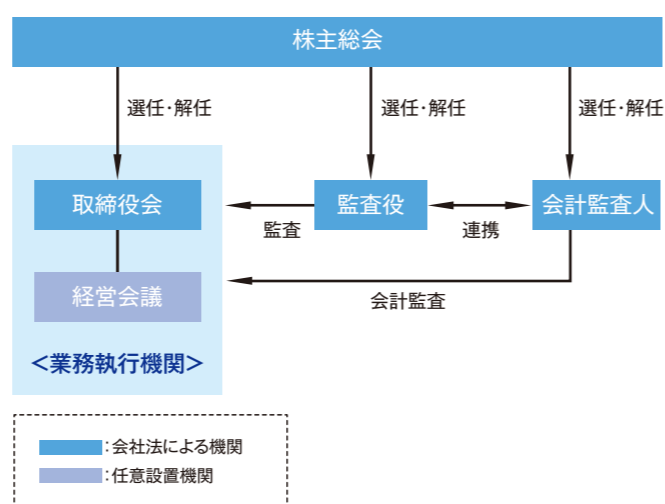
組織図



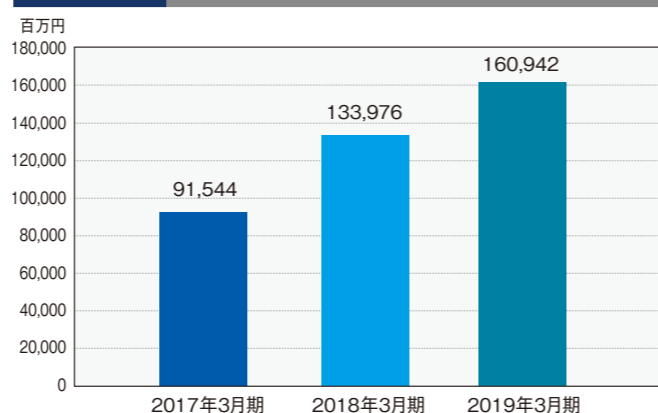
取締役、監査役及び執行役員

| | | |
|--------------|--------|---------------------------------|
| ■取締役 | | |
| 代表取締役 | 金井 史幸 | |
| 取締役 | 神谷 勇二 | |
| 取締役(非常勤) | 近藤 博昭 | |
| | 谷田川 英治 | |
| | 中村 正樹 | |
| ■監査役 | | |
| 監査役 | 村川 盛雄 | |
| ■執行役員 | | |
| 社長執行役員 | 金井 史幸 | 業務執行の統括 |
| 専務執行役員 | 神谷 勇二 | 管理部門、倫理・コンプライアンス、 情報セキュリティ担当 |
| 常務執行役員 | 小川 雲龍 | 技術開発、マーケティング戦略担当 |
| 執行役員 | 柳川 秀宏 | 製品開発、生産・品質保証担当 |
| | 塚田 和徳 | 営業担当 |

コーポレートガバナンス

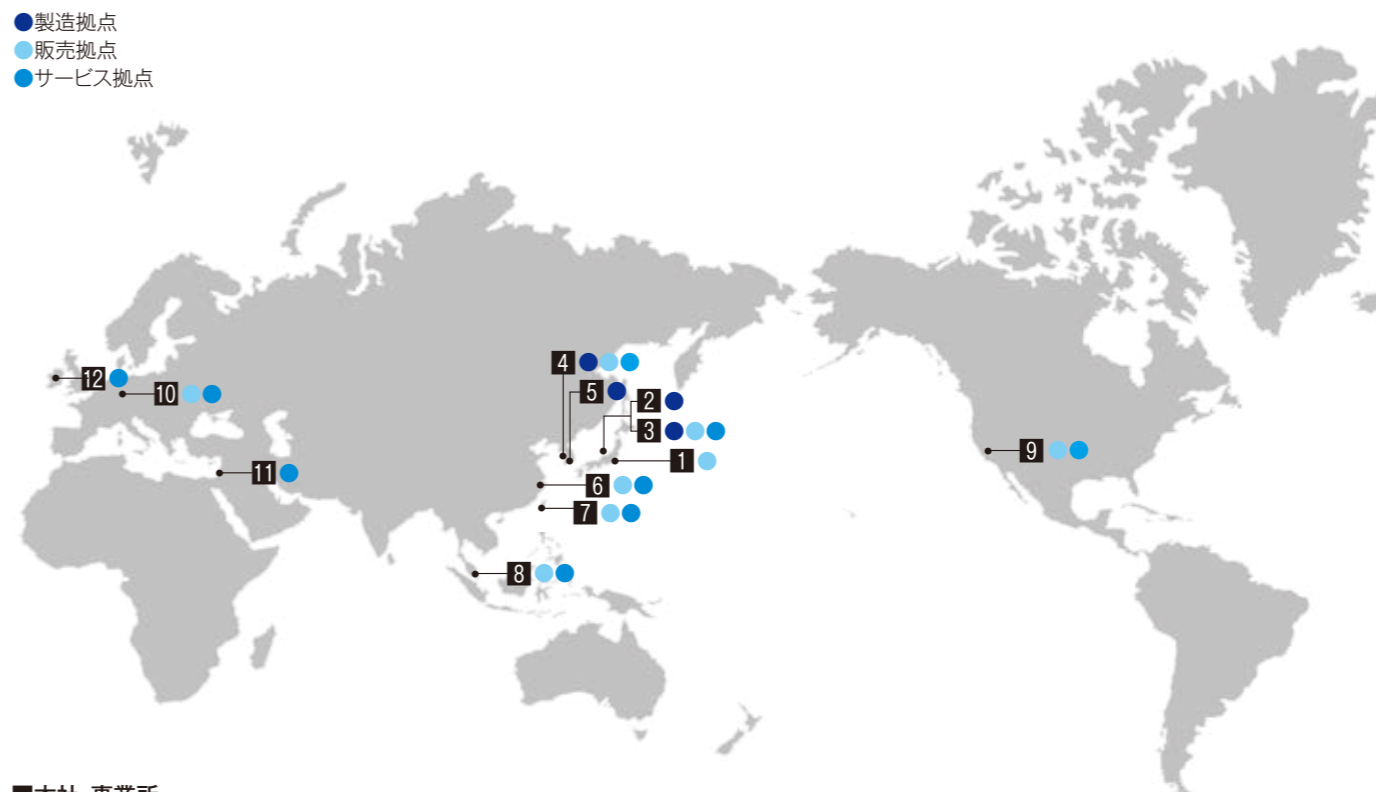


売上高(連結)



注)本数値は未監査の参考値です。
売上高は4月1日から3月31日までを1会計期間として記載しています。
2019年3月期は日本基準により計算、過年度分は国際財務報告基準(IFRS)に基づいて計算、表記しています。

事業拠点・グループ企業



■本社・事業所

| | |
|-------|---|
| 本社 | 1 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 TEL.03-5297-8530 |
| 富山事業所 | 2 〒939-2393 富山県富山市八尾町保内2-1 TEL.076-455-9111 |

■国内グループ会社

| | |
|----------------------|--|
| 株式会社国際電気セミコンダクターサービス | 3 〒939-2393 富山県富山市八尾町保内2-1 TEL.076-454-5931 |
|----------------------|--|

■海外グループ会社

| | |
|---|--|
| ＜アジア＞ | |
| Kook Je Electric Korea Co., Ltd. | 4 (Chaam-dong) 46, 2gongdan 8-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungnam 31075, Korea TEL.+82-41-559-1705 |
| | 5 64, Jinwisandan-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17709, Korea TEL.+82-31-8015-8300 |
| KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. | 6 Room ABJ, 22F World Plaza, No.855 Pudong Road South, Pudong New Area, Shanghai 200120, China TEL.+86-21-6888-1166 |
| Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd. | 7 9F, No.282 Beida Road, Hsin Chu City, Taiwan 300 TEL.+886-3-528-5788 |
| | 8 31 Tannery Lane, #03-01 HB Centre II, Singapore 347788 TEL.+65-6848-2633 |



本社 富山事業所

＜北米＞

| | |
|---|--|
| Kokusai Semiconductor Equipment Corporation | 9 2460 North First Street, #290, San Jose, CA 95131, U.S.A. TEL.+1-408-456-2750 |
|---|--|

＜欧州＞

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kokusai Semiconductor Europe GmbH | 10 Gruitener Strasse 3, D-40699 Erkrath, Germany TEL.+49-2104-9655-0 |
| | 11 Intel, M.S. LCS2-3S, Shderot Ha-Avatz Str. P.O.Box 1000, Kiryat Gat 82109, Israel TEL.+972-8612-3791 |
| | 12 Unit H9, Maynooth Business Park, Maynooth, Co. Kildare, Ireland TEL.+353-1-606-8487 |